

半導體工程系 微電子應用技優專班 四技 111 學年度入學課程結構規劃表

課程類別			一年級																		二年級																		三年級																		四年級																	
			第一學期						第二學期						第一學期						第二學期						第一學期						第二學期						第一學期						第二學期																													
			課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數	課程名稱		學分	時數																																
校共同必修課程			應修學分數		12學分		實務應用文		2	2	中文閱讀與表達		2	2	實用英文(一)		2	2	實用英文(二)		2	2	實用英文(三)		2	2	實用英文(四)		2	2																																												
			體育(一)		0	2	體育(二)		0	2	體育(三)		0	2	體育(四)		0	2																																																								
			服務教育(一)		0	2	服務教育(二)		0	2																																																																
系專業課程	核心通識課程	海洋科技與文明發展		應修學分數		6學分		核心(一)海洋科技探索2/2				核心(一)海洋文明發展2/2				核心(二)生命與倫理2/2				核心(二)在地文化探源2/2				核心(三)創意與創新2/2				核心(三)運算與程式設計2/2																																														
		生命探索與在地關懷		6學分																																																																						
		創意創新與數位知能		1學分																																																																						
	博雅通識課程	美感與人文素養		應修學分數		10學分		博雅通識/學分數/時數				博雅通識/學分數/時數				博雅通識/學分數/時數				博雅通識/學分數/時數				博雅通識/學分數/時數				博雅通識/學分數/時數																																														
		科技與環境永續		5大課群																																																																						
		社會與知識經濟		至少任選3																																																																						
		歷史與多元思維		課群)																																																																						
		全球與未來趨勢																																																																								
		跨課程群認列																																																																								
學院共同課程 (由學院開課)			選修				工程實作實習/3/3																																																																			
學院跨領域課程 (由學院開課)			選修				光：訊號與能源/3/3				機器人程式編程與演算法概念/2/2				虛擬實境互動實務/1/3				3D列印實務/1/3				智慧科技應用專論/3/3				車用電子應用及實務/3/3																																															
系專業課程	必修	應修課程數		14門/		應修學分數		40學分		電路學(一)		3	3	電路學(二)		3	3	電子學(一)		3	3	電子學(二)		3	3	專題製作(一)		3	3	專題製作(二)		3	3	專題製作(三)		3	3	專題製作(四)		3	3																																	
		普通物理		3	3	微積分(一)		3	3					電腦輔助電路設計與實驗		1	3																																																									
		數位邏輯		3	3	計算機與程式應用		3	3																																																																	
		微積分(二)		3	3																																																																					
	半導體製程設備組																																																																									
	鐵道機電整合組																																																																									
半導體製程設備組 與鐵道機電整合組																																																																										

備註：

一、畢業總學分數為 128 學分。

二、專業課程必修 40 學分，專業課程選修 60 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)

三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。

四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之各類英檢成績或 114 學年度起通過校內英語畢業門檻檢定考試。113(含)學年度前在學期間參加 2 次各類英檢考試，未通過者，須提出考試成績證明始得以下列其中一種方式通過：
1.通過校內英語畢業門檻檢定考試。2.參加一期外語教育中心開設之短期英文加強課程，並符合課程簡章規定。3.修讀並通過就讀院系開設 2 學分以上全英授課專業課程 1 門。114 學年度起，在學期間參加一次各類英檢考試或八次校內英語畢業門檻檢定考試，未通過者，應提出考試成績證明，重複修讀實用英文(三)或實用英文(四)並獲通過，且該重複修讀課程不計入畢業學分。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分);多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。

五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。

六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：

1.於就學期間，需通過相關專業檢定(證照之張數及類別如下：一張電機、電子類相關證照或二張資訊類相關證照)，附有證明文件，經審查合格，始得畢業。

2.「IC 產業介紹與應用」、「全球鐵路列車發展概述」、「微電子創意應用研討」、「3D 繪圖與電路板佈局實習」課程為必修科目。

3.學生可依大一、大二修習系上專業課程之總成績排名，依序選擇「半導體製程設備組」、「鐵道機電整合組」作為畢業前修課的方向，各組人數以全班人數之一半為分配原則。

4.各組學生修習所屬組內專業選修課程至少大於 18 學分。

5.除修習創新創業教育中心學分學程、第一校區電子工程系鐵道相關課程外，承認外系(非通識)選修學分至多 12 學分為專業選修，其中非本院開設之專業選修課程至多承認 6 學分。



114. 11. 25